

機械加工ではできない！ 微細レーザー加工の基礎と応用

こんなお困りに、効きます！

- 微細形状・狭い箇所・薄板など、切削や放電加工で限界を感じている
- レーザー加工に興味はあるが、種類や選び方、得意・不得意が分からない
- 硬脆材・金型・工具等への適用例や、機械加工との使い分けを知りたい
- 導入検討に必要な基礎知識と評価ポイントを短時間で整理したい 等々

参加無料
定員10名

日時 令和8年12月14日（月） 14:00～17:00

会場 九州工業大学情報工学部飯塚キャンパス実習棟（飯塚市川津680-4）

受講対象 福岡県内企業の従業員

申込方法 下記URLまたは二次元コードからお申込みください。

<https://form.cird.or.jp/r8bisailaser>

申込締切：12月7日（月）

* 締切日以降のお申し込みはお問い合わせください。

* 原則、先着順ですが、申込多数の場合は1社あたりの参加人数を制限させていただくことがあります。

申し込み
フォーム



講師：(株)ソディック

本講座は、レーザーに関する予備知識がない方を対象として、微細レーザー加工の基礎から金型・金属加工への応用までを、分かりやすく解説します。

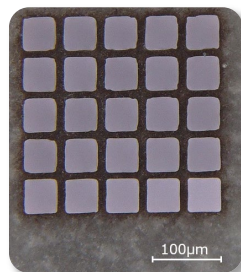
切削・研削・放電加工などの経験を土台に、近年注目度を増すレーザーだからこそ可能になる「非接触」「微細」「局所」「高自由度」な加工特徴と、従来工法との使い分けを、加工事例を交えて紹介します。

【講演内容】

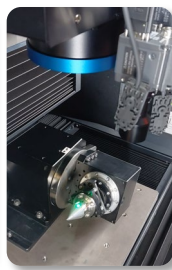
レーザー加工の基礎：光・波長・パルス幅・集光・エネルギー密度をやさしく解説
微細加工ができる理由：熱影響、除去メカニズム、スポット径と加工品質の関係
機械加工との違い：工具摩耗、加工反力、届きにくい部位、難削材への対応
金型・金属加工への応用：微細穴、溝、テクスチャ、トリミング、表面機能付与
加工事例で学ぶ得意・不得意：加工精度、速度、品質、コストの見方
設備構成と導入検討：発振器、光学系、走査系、ステージ、安全対策の基礎
質疑応答・意見交換：自社課題への適用可能性を考えるヒント

【受講後に得られること】

レーザー加工の基本用語と加工原理を理解できる。
機械加工・放電加工との違いを踏まえ、適用候補を判断できる。
テスト加工や設備導入で確認すべきポイントを整理できる。



セラミック材への穴加工



講座内容に関するお問い合わせ先

九州工業大学 大学院情報工学研究院 教授 檜原弘之
TEL：050-1738-7305
E-mail：nara@ics.kyutech.ac.jp
〒820-8502 福岡県飯塚市川津680-4

申込手続き等に関するお問い合わせ先

公益財団法人 飯塚研究開発機構 担当：川原・村田
TEL：0948-21-1156 FAX：0948-21-2150
E-mail：kawahara@cird.or.jp
〒820-8517 福岡県飯塚市川津680-41